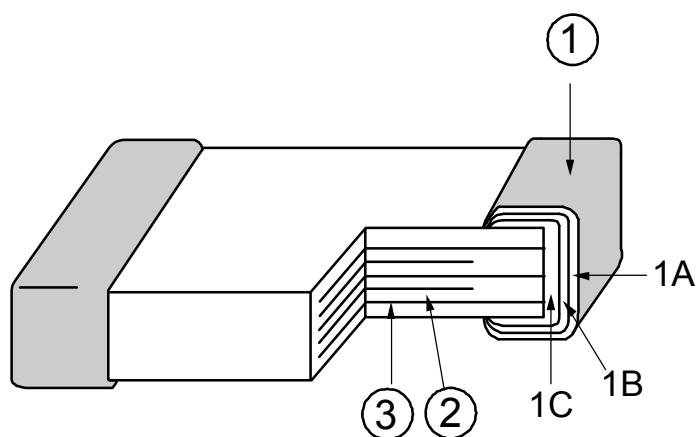


チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表 Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<GJ4/GJ8 Series>

1. 内部構造/Structure



2. 材料名/Material

| No. | 名称/Name | 主原料/Material |
|-----|----------------------------|----------------------|
| ① | 外部電極 Termination | |
| | 1A めっき層 Plated layer | すず Tin |
| | 1B めっき層 Plated layer | ニッケル Nickel |
| | 1C 下地電極 Electrode | 銅 Copper |
| ② | 誘電体素子 Dielectric layer | チタン酸バリウム系 Ceramic |
| ③ | 内部電極 Inner electrode | ニッケル Nickel |